

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】令和6年4月3日(2024.4.3)

【国際公開番号】WO2023/277083  
 【出願番号】特願2023-532032(P2023-532032)

【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 6 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 5 K 3 / 3 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 5 K 1 / 1 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

10

【F I】

H 0 1 L 2 1 / 9 2 6 0 4 F

H 0 5 K 3 / 3 4 5 0 2 E

H 0 5 K 1 / 1 4 E

【手続補正書】

【提出日】令和5年11月22日(2023.11.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路部材の電極にはんだバンプを形成するはんだバンプ形成方法であって、  
 複数の凹部を有し、当該凹部の構成部分がはんだ粒子の融点において変形可能な変形部  
 を有するはんだバンプ形成用部材を用意する工程と、

前記はんだバンプ形成用部材の前記凹部に保持されたはんだ粒子を前記電極と対向配置  
 する工程と、

前記電極を前記はんだ粒子の融点以上の温度に加熱する工程と、

30

前記電極を前記はんだバンプ形成用部材に押し当てる工程と、を備え、

前記変形部を変形させることで前記凹部に保持された前記はんだ粒子を前記電極に接触  
 させ、前記はんだ粒子を前記電極に転写してはんだバンプを形成するはんだバンプ形成方  
 法。

【請求項2】

前記電極を前記はんだバンプ形成用部材に押し当てた状態で前記はんだ粒子の融点以上  
 の温度に加熱する請求項1記載のはんだバンプ形成方法。

【請求項3】

前記複数の凹部のそれぞれに前記はんだ粒子を単体で配置する請求項1記載のはんだバ  
 ンプ形成方法。

40

【請求項4】

前記複数の凹部のそれぞれに前記はんだ粒子を複数配置する請求項1記載のはんだバン  
 プ形成方法。

【請求項5】

前記はんだ粒子のC・V値が20%以下である請求項4記載のはんだバンプ形成方法  
 。

【請求項6】

前記はんだ粒子の平均粒子径が1μm～35μmである請求項1～5のいずれか一項記  
 載のはんだバンプ形成方法。

50